

# Technologie salle blanche et caractérisation

## Réalisation du circuit intégré MOSTEC

### Diodes diffusées

Mohamed Hage Hassan  
Lucien Dos Santos  
Nathanal Marty  
Ayoub Bargach  
Benjamin Bony

14 Mars, 2017

## Table des matières

<b>1</b>	<b>Introduction</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Première séance</b>	<b>2</b>
2.1	Observation zones actives et nettoyage des plaques . . . . .	2
2.2	Oxydation thermique . . . . .	2
2.3	Modélisation dopage . . . . .	2
2.4	Étude oxyde de champ . . . . .	2
2.5	Étude dopage : R-carré . . . . .	2
2.6	Retrait du verre de phosphore . . . . .	2
2.7	Présentation Pulvérisation cathodique . . . . .	2
2.8	Dépot Aluminium : R-carré Alu . . . . .	2
<b>3</b>	<b>Deuxième séance</b>	<b>2</b>
3.1	Etallement résine, photolithographie . . . . .	2
3.2	Gravure humide de l'aluminium . . . . .	2
3.3	Nettoyage RIE face arrière . . . . .	2
3.4	Mesure de motif profilomètre . . . . .	2
<b>4</b>	<b>Conclusion</b>	<b>2</b>

# 1 Introduction

## 2 Première scéance

2.1 Observation zones actives et nettoyage des plaques

2.2 Oxydation thermique

2.3 Modélisation dopage

2.4 Étude oxyde de champ

2.5 Étude dopage : R-carré

2.6 Retrait du verre de phosphore

2.7 Présentation Pulvérisation cathodique

2.8 Dépôt Aluminium : R-carré Alu

## 3 Deuxième scéance

3.1 Etalement résine, photolithographie

3.2 Gravure humide de l'aluminium

3.3 Nettoyage RIE face arrière

3.4 Mesure de motif profilomètre

## 4 Conclusion